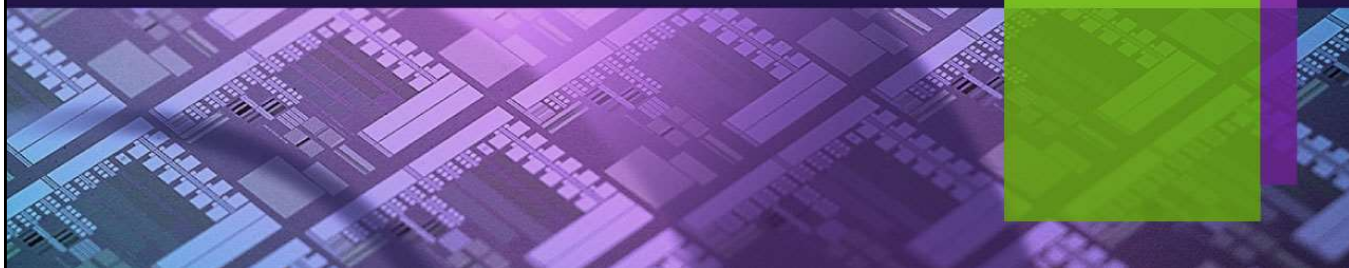


2025年3月期 第2四半期（2024年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2024年11月12日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

第2四半期 連結決算の概要

2024年11月12日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。私から、2025年3月期、第2四半期 連結決算の概要 を
ご説明いたします。

損益状況（四半期）

(億円)

	FY2024			FY2025		vs. Q1 FY2025	vs. Q2 FY2024
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
売上高	4,278	4,636	5,472	5,550	5,665	+2.1%	+32.4%
売上総利益	1,897	2,221	2,561	2,640	2,599	-1.5%	+37.0%
売上総利益率	44.3%	47.9%	46.8%	47.6%	45.9%	-1.7pts	+1.6pts
販管費	935	896	1,108	982	1,117	+13.7%	+19.4%
営業利益	961	1,324	1,452	1,657	1,481	-10.6%	+54.1%
営業利益率	22.5%	28.6%	26.5%	29.9%	26.2%	-3.7pts	+3.7pts
税金等調整前当期純利益	981	1,344	1,578	1,672	1,536	-8.2%	+56.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	731	1,015	1,249	1,261	1,177	-6.7%	+60.9%
研究開発費	510	497	584	534	620	+16.1%	+21.6%
設備投資額	176	318	329	239	533	+122.2%	+202.1%
減価償却費	125	138	153	132	145	+9.9%	+15.3%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

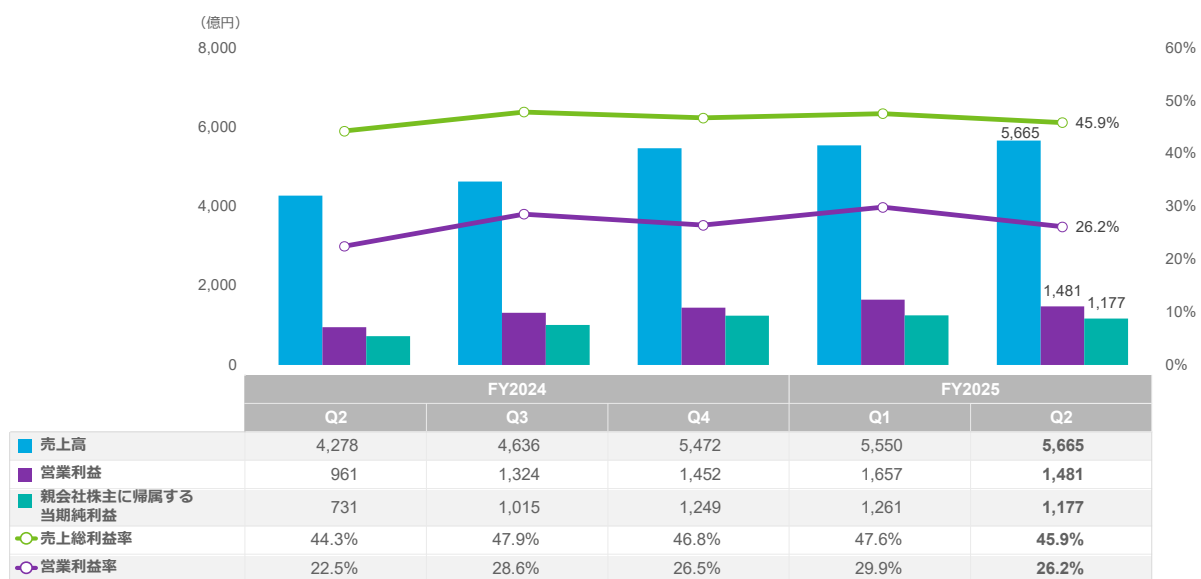
Investor Relations / November 12, 2024

TEL

4

こちらは、四半期毎の「損益状況」です。青枠の部分を中心にご覧ください。第2四半期の売上高は、前四半期比 2.1%増加の 5,665億円となりました。売上総利益は、1.5%減少の 2,599億円。売上総利益率は、一過性の在庫廃棄およびプロダクトミックスの変化により、1.7ポイント減少の 45.9%となりました。営業利益は、前四半期比 10.6%減少の、1,481億円。営業利益率は、前述した売上総利益率の減少ならびに、研究開発費を主とした販管費比率の増加により、前四半期比 3.7ポイント減少 26.2%となりました。税金等調整前当期純利益は、8.2%減少の 1,536億円、また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 6.7%減少の 1,177億円となりました。第2四半期の設備投資額の主な内訳は、現在建設中の、東京エレクトロン宮城の開発棟および東京エレクトロン九州の開発棟でございます。

損益状況（四半期）



Investor Relations / November 12, 2024

TEL

5

こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しております。前期上期を底として、売上が回復していることがご覧いただけるかと存じます。

損益状況（半期）

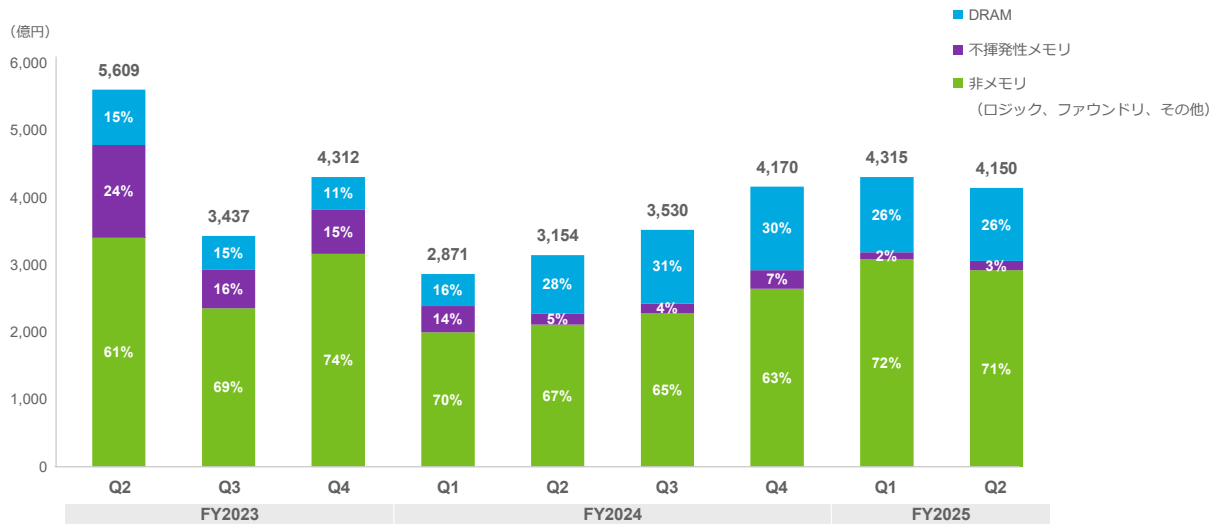
（億円）

	FY2024		FY2025	vs. FY2024 H2	vs. FY2024 H1	(ご参考)
	H1	H2	H1			8月8日発表 FY2025 H1 予想
売上高	8,195	10,109	11,216	+10.9%	+36.9%	11,000
売上総利益	3,520	4,782	5,239	+9.6%	+48.8%	5,040
売上総利益率	43.0%	47.3%	46.7%	-0.6pts	+3.7pts	45.8%
販管費	1,734	2,005	2,100	+4.7%	+21.1%	2,160
営業利益	1,785	2,776	3,139	+13.0%	+75.8%	2,880
営業利益率	21.8%	27.5%	28.0%	+0.5pts	+6.2pts	26.2%
税金等調整前当期純利益	1,811	2,923	3,208	+9.8%	+77.1%	2,900
親会社株主に帰属する当期純利益	1,374	2,264	2,439	+7.7%	+77.4%	2,180
研究開発費	946	1,081	1,154	+6.7%	+22.0%	1,210
設備投資額	570	648	773	+19.3%	+35.6%	-
減価償却費	231	291	277	-5.0%	+19.5%	-

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

こちらは半期ベースの業績を示しております。青枠で囲っている箇所が、今上期の損益状況でございます。一番右に、8月8日に発表しました今上期の業績予想数値を表示しております。ご覧のとおり、全ての項目において、8月8日発表の計画を達成いたしました。前期下期との比較におきましては、堅調な顧客需要を背景に、売上・利益ともに上回りました。前期上期との比較におきましても、お客様の投資の回復とともに、業績が大きく上昇しているのがおわかりいただけるかと存じます。なお、半期の売上高としましては、過去2番目に高い水準となりました。

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

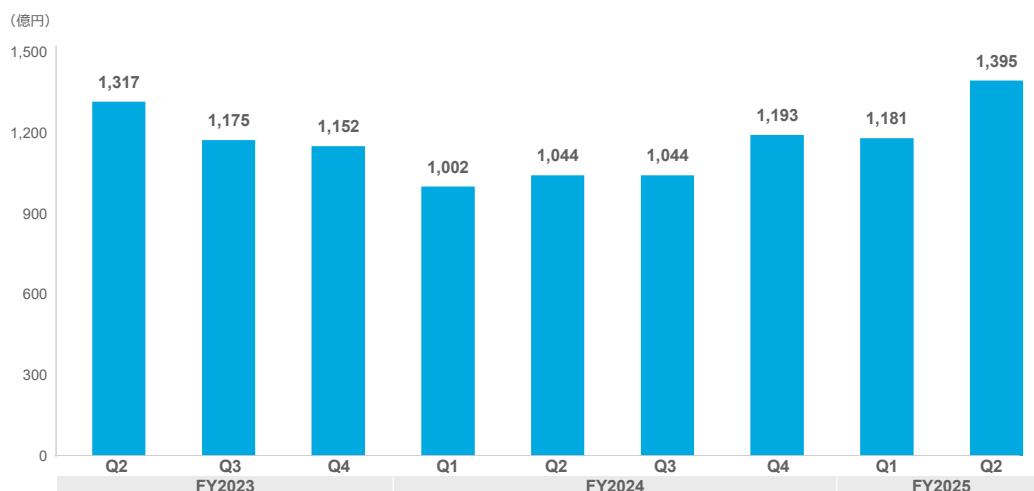


*1 SPE：半導体製造装置

*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

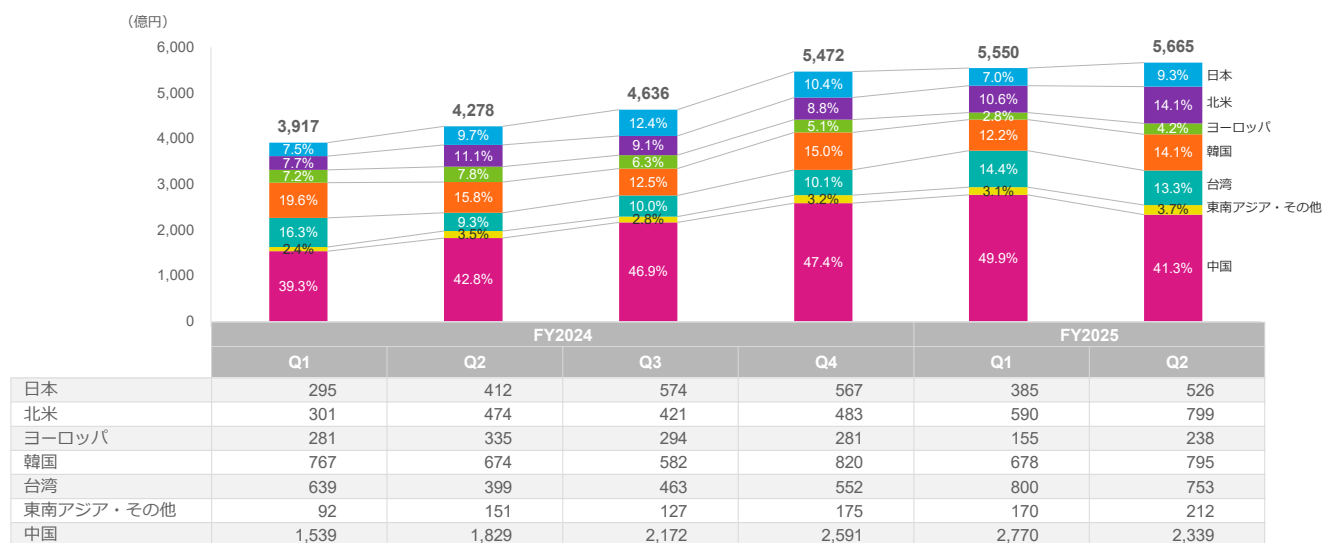
こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。第2四半期は、下から非メモリ 71%、不揮発性メモリ 3%、DRAM 26%で、前四半期と同様の構成比となりました。新規装置の売上高としましては、前四半期での前倒し計上もあり、第2四半期では若干の減少がみられますが、お客様からの引き合いは、引き続き堅調に推移しております。

フィールドソリューション売上高（四半期）



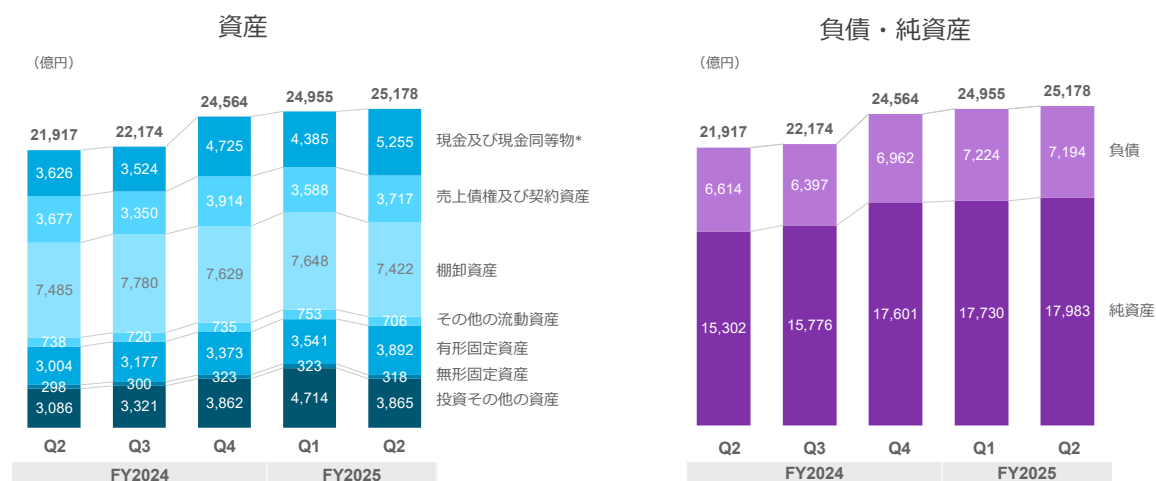
こちらは、「フィールドソリューション売上高」です。第2四半期は214億円増加の、1,395億円となりました。改造案件が売上増をけん引したほか、パーツ・サービス売上についても、顧客稼働率が回復傾向にあり、増加いたしました。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～FY2025 Q2）



こちらは、「地域別売上高」です。第2四半期におきましては、中国の構成比率が前四半期比8.6ポイント減少し、41.3%となりました。その他の地域の構成比率は概ね上昇いたしました。また、中国の構成比率は、上期から下期にかけて下がる見通しです。

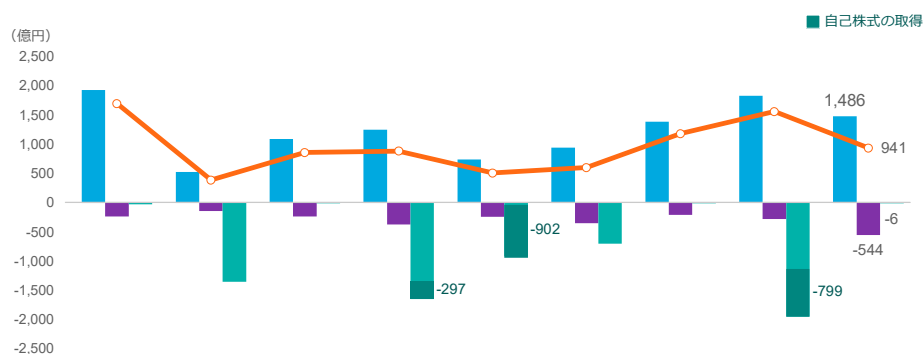
貸借対照表（四半期）



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。資産合計は、2兆5,178億円となりました。現金同等物は、5,255億円。前四半期から870億円増加いたしました。売上債権及び契約資産は、前四半期比128億円増加の3,717億円。棚卸資産は、前四半期比225億円減少の7,422億円。投資その他の資産は保有する株式の時価減少などにより、前四半期から849億円減少し、3,865億円となりました。続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から30億円減少の7,194億円となりました。純資産は、前四半期比253億円増加の1兆7,983億円となりました。主な変動要因は、純利益の計上による増加、その他有価証券評価差額金の減少などがございます。なお、自己資本比率は70.8%となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023			FY2024				FY2025	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
■ 営業キャッシュ・フロー	1,934	532	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837	1,486
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-231	-138	-231	-368	-234	-344	-203	-273	-544
■ 財務キャッシュ・フロー	-21	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944	-6
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	1,702	393	865	888	514	606	1,187	1,564	941
手元資金残高 ^{*3}	4,846	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

Investor Relations / November 12, 2024

最後に、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。この四半期における営業キャッシュ・フロー獲得は、1,486億円でございます。投資キャッシュ・フローの支出は、主に固定資産の取得に伴い、544億円。財務キャッシュ・フローの支出は、6億円。なお、フリーキャッシュ・フローは、941億円となりました。以上、2025年3月期 第2四半期「連結決算の概要」をご報告いたしました。

事業環境および業績予想

2024年11月12日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



河合でございます。「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

事業環境（2024年11月時点でのWFE市場の見方）

■ CY2024：\$100B強と予測。期初の想定を上回る勢い

- 旺盛なAIサーバー需要。AI搭載型PC・スマホ向け需要を見込んだ先行投資も活発
 - ・ AIサーバー向け投資比率 15%（昨年比1.5倍に拡大）
 - ・ AI搭載型PC・スマホ向け投資比率 15%
 - ・ 従来型サーバー・PC・スマホ向け投資比率 35%

■ CY2025：二桁成長を期待

- AI比率上昇。DRAMのさらなる拡大に加え、NANDも在庫調整が進捗し投資再開。先端口ジック/ファウンドリ向けの設備投資も増加し、成熟向け投資の一服感をオフセット
 - ・ AIサーバー向け投資比率 20%
 - ・ AI搭載型PC・スマホ向け投資比率 20%
 - ・ 従来型サーバー・PC・スマホ向け投資比率 30%

大容量・超高速・低消費電力の実現に向けた技術革新が進展。GAA^{*1}・Backside PDN^{*2}・HBM^{*3}や、三次元実装におけるテスト工程など、TELの事業機会は拡大

^{*1}GAA (Gate All Around)

: トランジスタのチャネル全面をゲートで覆った構造

^{*2}Backside PDN (Power Delivery Network)

: 電源供給配線をシリコンの裏面に配置する構造

^{*3}HBM (High Bandwidth Memory)

: 高帯域幅DRAM

Investor Relations / November 12, 2024

TEL 13

まず、「事業環境」について、ご説明します。CY2024のWFE市場は、前回8月時点と変わらず、100B強と見ています。一部、先端口ジック向け投資は控えられているものの、それを上回る非常に強いAI需要に支えられ、期初の想定を上回る勢いです。

足元では、引き続き旺盛なAIサーバー向け投資が続いています。WFE全体に占めるAIサーバー比率は約15%、昨年比1.5倍もの投資規模ですが、その約半分はHBM用途です。また、AI搭載型PCやスマートフォンの本格普及に向けた先行投資も活発化しており、こちらも全体の15%程度にまで増加しています。このように非常に強いAI需要に牽引され、特にHBM用途のDRAM投資が活況です。また、先端口ジック/ファウンドリにおいては、2nm、3nm、4nmといった微細化・量産投資のみならず、アドバンスドパッケージングやテストのニーズも急拡大しています。CY2025は、好調なAIサーバーに加えて、PC・スマートフォンのAI搭載比率が上昇すると見込まれます。

すべて合わせて、AI比率が全体の40%にまで拡大します。今後、CY2030には、半導体デバイスに占めるAI半導体比率が70%を占めるという調査会社のデータもありますが、WFEにおけるAI比率も、徐々に高まってきています。先行するDRAMに加えて、NANDも在庫調整が進捗し、投資の再開が期待されます。また、先端口ジック/ファウンドリの設備投資も本格回復し、成熟向け投資の一服感をオフセットすると予測しています。これらを背景に、CY2025のWFEは、二桁成長になると期待しています。AI用途には、最先端の半導体技術が求められます。大容量、超高速、低消費電力の半導体デバイスの実現に向け、技術革新が進展します。GAA、Backside PDN、高積層メモリなどの技術進化に伴い、当社のビジネス機会はますます拡大していきます。

FY2025 Q2 事業進捗

- 売上・利益等、すべての指標において計画を達成
 - Q2 : 売上高 5,665億円、営業利益 1,481億円、営業利益率 26.2%
 - H1 : 売上高 1兆1,216億円、営業利益 3,139億円、営業利益率 28.0%
- 先端ロジック、HBM用途のDRAM、Advanced Packaging用途の引き合いが増加
 - 先端向け量産投資の本格化に伴い、新製品比率が上昇
 - 通期で過去最高の売上高、売上総利益、売上総利益率、営業利益、当期純利益およびEPSを見込む
- 戦略製品によるPOR*獲得・開発評価も順調に進捗
 - DRAM向けHigh-k成膜装置、NAND向け高生産性の枚葉洗浄装置、HBM向けTemporary bonder、最先端ロジック (Backside PDN) Bonder、DRAM向けProberなどでPORを獲得。
また、Advanced packaging (SoC) 向けBonderにおいては、開発PORを獲得
 - NAND向け極低温エッチングにおいても、量産POR獲得に向けて著しい進捗

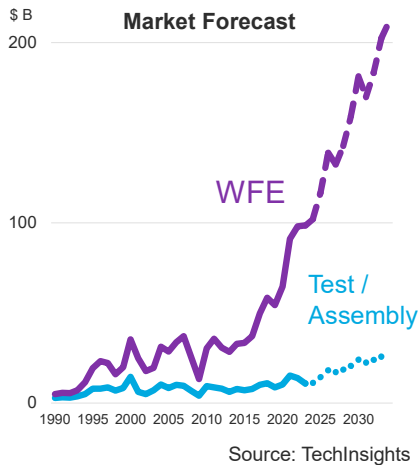
* POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

Investor Relations / November 12, 2024

TEL 14

次に、「FY2025 第2四半期の事業進捗」についてご説明します。業績については、先ほど川本から説明しました通り、売上・利益、すべての指標において計画を達成しました。最先端向けの量産投資の本格化に向け、先端ロジック、HBM用途DRAM、アドバンスドパッケージへの引き合いが増加し、新製品比率を押し上げており、それが、今期通期での過去最高の売上・利益につながる見込みです。のちほど全体像をお見せしますが、今期も、付加価値の高い戦略製品で、PORを順調に獲得しております。DRAM向けCapacitor High-k成膜装置や、NAND向け24チャンバーの、高制御・高生産性の枚葉洗浄装置でPORを獲得。今後さらなる拡大が期待されるBonderについては、すでに主要顧客において高いシェアを得ているHBM向けTemporary Bondingで新規顧客のPORを獲得できました。また、最先端ロジックにおけBackside PDN、及び、Advanced PackageにおけるSoC向けFusion BondingのPORを獲得したことも大きなTopicsです。Proberも、最先端ロジックでは圧倒的なシェアがあり、前年比2倍にも迫る勢いで売り上げを伸ばしておりますが、今期はDRAMにおいても温度制御の優位性より、主要顧客の量産PORを獲得しました。皆様にご期待いただいております、極低温エッチングは、複数社で、量産POR獲得に向けて著しい進捗が確認できています。

ScalingとPackaging/Testにより拡大するTELの事業機会



Logic: GAA, BSPDN <ul style="list-style-type: none"> EUV Coater/Developer Gas Chemical Etch Conductor Etch PVD Metal Overburden CFET/Inner Spacer 埋め込み膜用プラズマCVD 両面スクラバ 裏面/ベベル洗浄 パターンシェーピング 	DRAM: DDR5, 3DDRAM <ul style="list-style-type: none"> EUV Coater/Developer Capacitor Mold Etch 大手独占 Batch High-k Capacitor成膜 PVD Metal Hard Mask 超臨界洗浄 裏面/ベベル洗浄 	Scaling
Logic Packaging <ul style="list-style-type: none"> Wafer Bonder Laser Tool 	HBM Packaging <ul style="list-style-type: none"> Wafer Bonder Laser Tool 	NAND: Beyond 4xx <ul style="list-style-type: none"> Slit Etch 大手独占 極低温エッチング Batch Mo成膜 Batch洗浄 WL Separation Wafer Bonder Laser Tool
最先端Logic/Memory テスト工程 <ul style="list-style-type: none"> Prober 昨年比 ~2倍の売上見込み 	Packaging / Test	

中期経営計画達成に向け、事業は順調に進捗。2025年2月26日にIR Dayを実施予定

さて、こちらのグラフは、半導体前工程装置 WFE市場と、後工程装置Test/Assembly市場の規模を表したTechInsights社のフォーキャストデータです。御覧のとおり、WFE市場と、Test/Assembly市場は、力強く成長することが期待されますが、それを牽引するのが、AIと、最先端デバイスです。右側に示しております、様々な開発アイテムが、現在、進行しております。圧倒的なボリュームの最先端ウエハプロセス装置と、成長著しいアドバンスドパッケージングやテスト装置、それぞれにおいて、数多くの量産POR、開発PORを獲得しており、これらはすべて、将来にわたる当社の成長ポテンシャルとなります。今期は、AI関連のみで6000億円以上の売上になりますが、今後も豊富なプロダクトラインナップを強みに、スケーリングとパッケージング双方で、当社の成長ポテンシャルを最大限に取り込んでいきたいと思います。中期経営計画の達成に向け、事業は順調に進捗しております。来期は、表に示すアプリケーション群で、当社の売上の約7割を占めると見ておりますが、当社の技術優位性を一層ご理解いただきたく、来年2月26日にIR Dayを実施する予定です。詳細は追ってご案内しますので、皆様ぜひ、ご参加ください。

FY2025 業績予想

次に、「FY2025の業績予想」について説明致します。

FY2025 業績予想

(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025				
		H1 (実績)	H2 (新予想)	通期 (新予想)	通期 修正額	通期 YoY
売上高	18,305	11,216	12,783	24,000	+1,000	+31.1%
売上総利益	8,302	5,239	6,050	11,290	+570	+36.0%
売上総利益率	45.4%	46.7%	47.3%	47.0%	+0.4pts	+1.6pts
販管費	3,740	2,100	2,389	4,490	+40	+20.1%
研究開発費	2,028	1,154	1,386	2,540	+10	+25.2%
研究開発費以外の販管費	1,711	945	1,003	1,950	+30	+14.0%
営業利益	4,562	3,139	3,660	6,800	+530	+49.1%
営業利益率	24.9%	28.0%	28.6%	28.3%	+1.0pts	+3.4pts
税金等調整前当期純利益	4,734	3,208	3,701	6,910	+610	+46.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	2,439	2,820	5,260	+480	+44.5%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	528.67	-	1,140.67	+103.73	+356.92

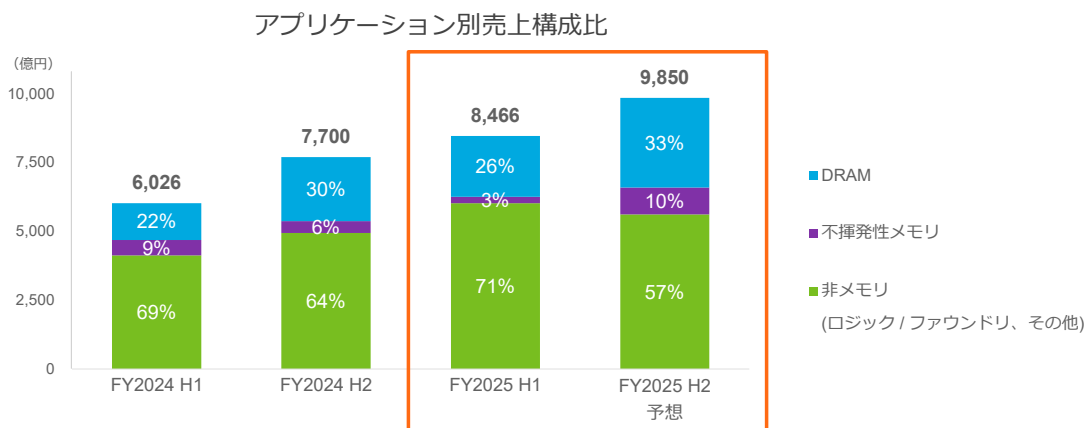
業績予想を再度上方修正。市場成長を大きくアウトパフォーム

Investor Relations / November 12, 2024

TEL 17

先程 ご説明させて頂きました通り、AI関連機器の需要に牽引され、WFE市場は 現在 回復基調にあり、CY2025に向けて、最先端メモリ、最先端ロジックの設備投資が本格化すると期待されます。上期実績および最新の市場動向を反映し、業績予想を上方修正します。FY2025は、通期で、売上高 2兆4,000億円、前期から、プラス31%の成長となり、市場成長を大きくアウトパフォームする見込みです。売上総利益 1兆1,290億円、営業利益 6,800億円、当期純利益 5,260億円、となります。また、将来の成長機会を最大限取り込むため、今期は2,540億円の 研究開発投資を予定しております。売上高、売上総利益、売上総利益率、営業利益、当期純利益、及び、EPSは、過去最高になる見込みです。

FY2025 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

FY2025H2は過去最高の半期売上を予想

こちらは、「FY2025の SPE 新規装置の 売上予想」です。ご覧の通り、前上期を底に、売上は回復基調です。今下期は、過去最高の 半期売り上げを予想しています。

FY2025 研究開発費・設備投資計画

新開発棟
成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県斐崎市
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟
コートデベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置

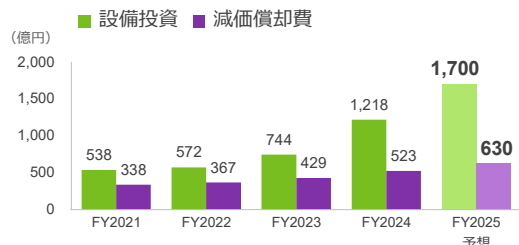
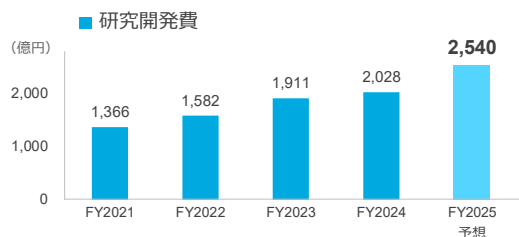


熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

新開発棟
エッチング装置



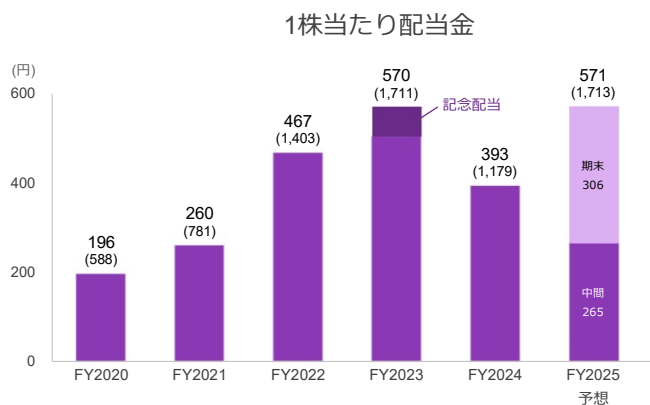
宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

次に、「研究開発費と設備投資の計画」です。FY2025は、いずれも過去最高となる見通しで、前述のとおり、研究開発費は、2,540億円、設備投資、減価償却費はそれぞれ、1,700億円、630億円を見込んでおります。

FY2025 配当予想



- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は571円を予定

次に、「配当予想」についてです。今期の業績予想修正に基づき、1株当たりの配当は、過去最高だった2023年3月期を上回り、通期で571円を予定しております。

自己株式の取得について

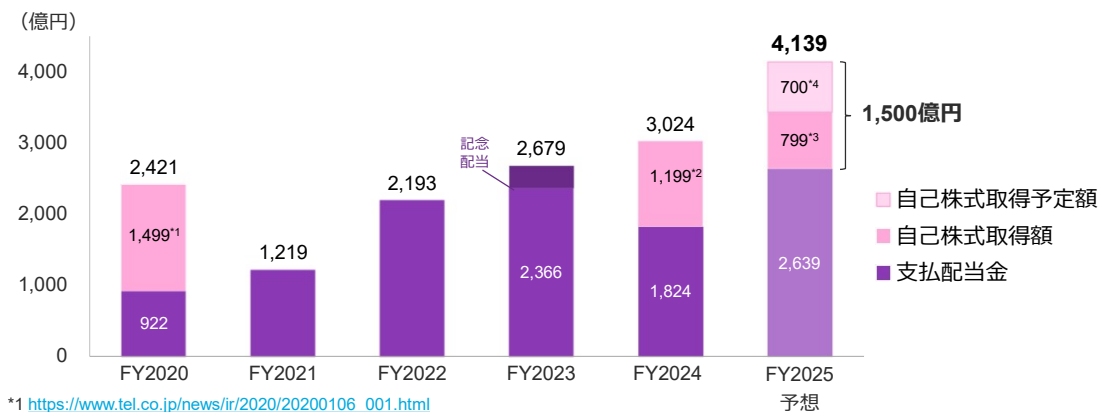
最大700億円の自己株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 350万株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 0.8%）
- 株式の取得価額の総額 : 700億円（上限）
- 取得する期間 : 2024年11月13日～2025年1月31日

キャッシュ創出力と必要手元資金、成長投資資金を考慮し、
今後も機動的にバランスシート・マネジメントをおこないます

また、本日の取締役会において、700億円を上限として自己株式を取得することを決定いたしました。当社は、今年2月に、今後の成長に向けて、今期より5年間で、研究開発費1.5兆円以上、設備投資も7,000億円以上、を計画していることを発表いたしました。今回の決定は、想定している来期以降の当社の成長投資とキャッシュ創出力の成長、および、現状のキャッシュポジションや資本効率の向上等を総合的に勘案したことによるものです。今後も拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、そして、資本効率の向上を見据え、機動的にバランスシート・マネジメントをおこなって参ります。

総還元額



*1 https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html

*2 https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf

*3 https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/tin2lg00000000c0-att/20240701_001.pdf

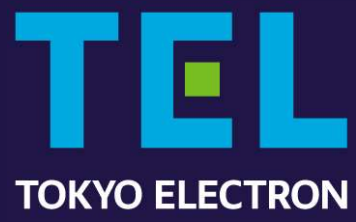
*4 https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/bknhch00000000ik-att/20241112_003.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高レベルの総還元額を見込む

Investor Relations / November 12, 2024

TEL 22

こちらは最後のスライド、「総還元額の推移」になります。今期の総還元額は、先程ご説明した1株あたり配当額と、今期追加で取得予定の自己株式を合わせ、過去最高だった前期2024年3月期を1,000億円以上上回り、4,139億円と、過去最高の総還元額になる見込みです。なお、取得した自己株式につきましては、基本的に消却する考えです。私からのご報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。



本資料の取扱い上の注意

当社の書面による承諾なしに複製、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

TEL および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。